

## 台灣機械產業進入半導體供應鏈低碳製程產業化論壇 邀請函

AI 需求與未來應用不斷加溫，從 6 月初 Computex 展以「AI 串聯、共創未來 (Connecting AI)」為主軸，聚集全球科技巨擘，讓台灣成為國際矚目焦點，也成功掀起全球 AI 旋風，展望未來，AI 商機及電子設備可望做為帶動台灣機械設備出口的火車頭，引領產業發展方向。

且因晶片需求大幅提高，台灣半導體成為全球矚目之產業焦點，機械產業運用原有堅實技術基礎，加上不斷創新研發與重要法人技術能量支援，希望能夠共同努力提高半導體供應鏈當中的自製比例。而機械產業在生產製造關鍵零組件、設備，甚至進入半導體供應鏈時，也需要因應國際淨零碳排的趨勢，將節能減碳的概念帶入其中。

因此，本會與財團法人工業技術研究院合作，共同主辦此低碳製程產業化論壇，希望透過此會議，邀請專家前來分享產業趨勢與說明技術發展方向，協助有意投入的廠商能夠更為深入瞭解半導體供應鏈低碳化需求與切入點，可作為未來技術發展方向的規劃參考。

主辦單位：臺灣機械工業同業公會、工業技術研究院機械與機電系統研究所

會議時間：113 年 10 月 23 日(三)下午 13:30-16:30

會議地點：南港展覽館一館 505C 會議室(台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓)



線上報名

時間	議程事項	報告人
13:00~13:30	報到	
13:30~13:40	主席致詞	機械公會長官
13:40~14:00	貴賓致詞	經濟部產業技術司長官 工研院機械所長官
14:00~14:50	全球綠色行動趨勢與台灣機械業切入半導體業機會	工研院產科國際所 岳俊豪組長
14:50~15:10	茶敘交流	
15:10~15:50	半導體產業邁向低碳化經驗談	SEMI/工研院綠能所(TBD)
15:50~16:30	臭氧產生及臭氧水在低碳製造之機會	工研院機械所 陳玠錡 副研究員
16:30~	產業交流	

(主辦單位保留調整議程之權利，實際議程以活動當天規劃為準。)

◆ 本案聯絡人：

機械公會聯絡人：政策服務組黃巧雲組長

E-mail: nancy@tami.org.tw; taminancy4671@gmail.com TEL: 02-2349-4666 ext 671

◆ 出席回條：

單位名稱	出席人姓名/職稱	
E-Mail	連絡電話	